

Groupe de travail mixité 24 Octobre 2008

Participants : F Massit MAATEL
 W Marais ID3 Semiconductors
 J Cethier AVANTEC
 D Michaux SCHNEIDER
 J Revial RAC Electronic
 G Bontemps ELC
 R Billat
 S Vidal

Objet de la réunion : Black Pad, Délamination, Alliages, Problèmes rencontrés . . .

Délamination : flux des crèmes à braser ou flux vagues peuvent ils entrainer des délaminations ?

Pb rencontrés dans flux à base eau, par exemple dans trou non métallisé

Flux à base alcool évaporation rapide, moins sujet à délamination

Comparatif flux base eau/alcool (profil, température . . .)

Echanges entre utilisateurs sur :

- Problèmes de séchage

- Voids dans trous métallisés

- « Cratères » dans soudures

Compromis temps de préchauffe

- Alliages SAC 305 / Sn100C

- Vernis épargne : moirage sur vernis épargne , vernis « pelable » (ne résiste pas à température)

- Fluo X : complexes organiques, vaporisation phénol, polymérisation parfois sur plages accueil

Même problème sur bonding

No clean et halogène, craquelures sur vernis

Nécessité de nettoyage plus poussé selon flux

Crème sans plomb vieillit plus vite qu'avec plomb, plus de flux

Capacités chimique / tantale

- Exposed pads / CAO vernis épargne / plages d'accueil

- BGA : retour au bout de 2/ 3 ans en général circuit doré pour planéité

Finition étain pur brillant, Sn diffuse dans Cu (devient jaune)

Prochaine réunion du groupe de travail vendredi 16 Janvier 14h au CEDMS